

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

2040586102

Status:

Active

Overview:

QSFP-DD Interconnect System and Cable Assemblies

Description:

QSFP-DD Assembly, Stacked 2x1, 4.50mm Tapered Fin Heat Sink

Documents:

3D Model

Test Summary 2040580002-000 (PDF)

Drawing (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

Agency Certification

CSA

LR19980

UL

E29179

General

Product Family

I/O Connectors

Series

204058

Application

Module-to-Board

Component Type

Receptacle

Electrical Model

Yes

Overview

QSFP-DD Interconnect System and Cable Assemblies

Product Name

QSFP-DD

Type

N/A

UPC

191128419895

Physical

Circuits (Loaded)

152

Circuits (maximum)

152

Color - Resin

Black

Durability (mating cycles max)

100

Flammability

94V-0

Gender

Female

Keying to Mating Part

None

Lock to Mating Part

Yes

Material - Metal

Copper Alloy

Material - Plating Mating

Gold

Material - Plating Termination

Tin

Material - Resin

High Temperature Thermoplastic

Net Weight

51.740/g

Number of Rows

2

Orientation

Right Angle

PC Tail Length

1.70mm

PCB Locator

Yes

PCB Retention

Yes

PCB Thickness - Recommended

1.53mm min.

Packaging Type

Tray

Panel Mount

N/A

Pitch - Mating Interface

0.80mm

Plating min - Mating

0.760µm

Plating min - Termination

0.760µm

Polarized to Mating Part

Yes

Polarized to PCB

Yes

Ports

2

Surface Mount Compatible (SMC)

No

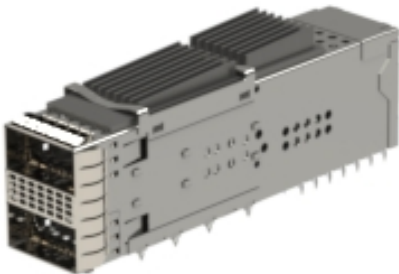
Temperature Range - Operating

-40° to +85°C

Termination Interface: Style

Through Hole - Compliant Pin

Electrical



Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

China RoHS

REACH SVHC

Not Contained Per -
ED/71/2019 (16 July
2019)

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

For more information, please visit [Contact US](#)

China ROHS

Green Image

ELV

Not Relevant

RoHS Phthalates

Not Contained

Search Parts in this Series

204058 Series

Application Tooling | [FAQ](#)

Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.

Global

Description	Product #
Extraction Tool for 2-by-1 QSFP-DD Multi-Port Connector with Press-Fit Tails	2001991270
Insertion Tool for QSFP-DD Cage Assembly with Heat Sink, 2-by-1 Multi-Port Connector with Elastomeric Gasket for SAN Applications with Heatsink	2002141230

Current - Maximum per Contact	0.5A
Grounding to Panel	Yes
Shielded	Yes
Material Info	
Reference - Drawing Numbers	
Sales Drawing	2040586103-ASY
Test Summary	2040580002-000

This document was generated on 10/03/2019

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9